

11;12

©1995

ОДНОВРЕМЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И ТЕМПЕРАТУР НА КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СЛОИ КРЕМНИЯ НА ВОЛЬФРАМЕ

О.Л.Голубев

Одной из основных проблем развития приборов современной вакуумной микроэлектроники является выбор катода. Лучше всего идеи вакуумной микроэлектроники реализуются на основе матричных автоэмиссионных катодов [1]. Такие катоды дают уже в настоящее время плотности эмиссионного тока до 1000 A/cm^2 при рабочих напряжениях 50–100 В. Важнейшими проблемами, которые требуют решения для дальнейшего развития подобных катодов, являются повышение плотности тока, крутизны вольт-амперной характеристики и снижение рабочего напряжения. Весьма эффективным способом решения подобных задач может быть термополевая (T - F) обработка — одновременное воздействие сильных электрических полей и относительно высоких температур на остряя-автоэмиттеры.

В данной работе изучалась T - F обработка поверхности автоэмиссионного катода, представлявшего собой вольфрамовое W -острие с радиусом закругления $r = 0.5$ – 0.7 мкм , на которое наносился слой кремния Si толщиной 900–1000 моноатомных слоев. Такая система лучше всего моделирует ситуацию, характерную для матричных автоэмиссионных катодов, когда эмитирующие конусы из Mo, Si и других материалов выращиваются на Si-подложке, причем характерные высоты таких конусов порядка 1–2 мкм и $r = 400$ – 500 A [2]. Система Si- W удобна также и тем, что позволяет сформировать достаточно “толстые” слои Si на поверхности W при различных температурах подложки вплоть до $T = 800 \text{ K}$, выше которой только начинается заметная диффузия атомов Si в объем W . При этом слои Si можно получить как относительно рыхлые при низких $t \sim 300 \text{ K}$, так и кристаллически упорядоченные — при $T = 600$ – 700 K .

В работе применялась методика полевой электронной микроскопии, вакуум в приборе — 10^{-10} – 10^{-11} Тор по адсорбирующему газам. Использовались низкие по сравнению с T - F обработкой металлов $T = 700$ – 1000 K и относительно умеренные поля $F = 0.3$ – 0.8 В/A . На поверхности W -острия было сконденсировано 900–1000 монослоев Si при

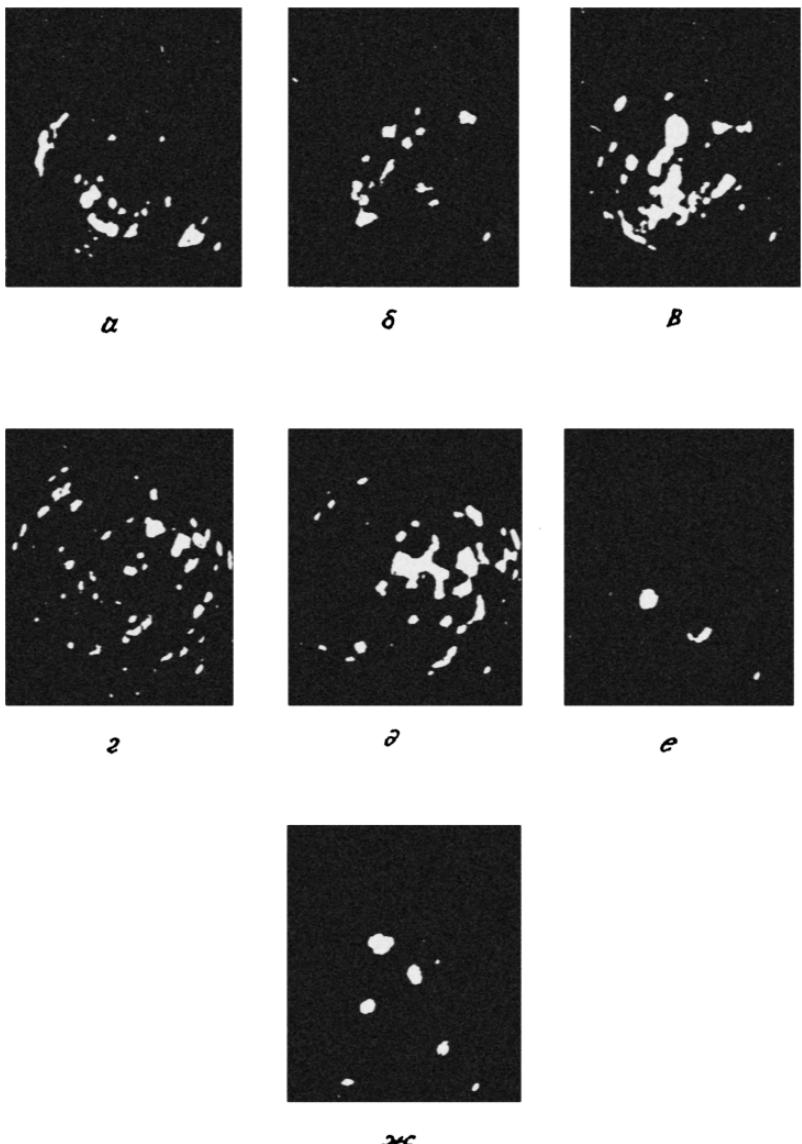


Рис. 1. Полевые электронные изображения поверхности слоя Si на W (толщина — 900 моноатомных слоев) на различных стадиях T - F обработки: *а* — исходное состояние, $U_{10} = 7190$ В; *б* — после обработки при $T_{об} = 700$ К и $F_{об} = 0.55$ В/А, начальная стадия перестройки в поле, $U_{10} = 6280$ В; *в* — после $T_{об} = 780$ К и $F_{об} = 0.66$ В/А, стадия глубокой перестройки, $U_{10} = 4700$ В; *г* — после $T_{об} = 870$ К и $F_{об} = 0.82$ В/А, большое число невысоких микровыступов, $U_{10} = 4540$ В; *д* — после прогрева состояния “*г*” при $T = 870$ К в отсутствие поля, макронаросты на поверхности; *е* — после $T_{об} = 980$ К и $F_{об} = 0.66$ В/А, два острых микровыступа, $U_{10} = 2960$ В; *жс* — после $T_{об} = 980$ К и $F_{об} = 0.82$ В/А, слабое затупление микровыступов, $U_{10} = 3210$ В.

Т подложки 620 К, когда на поверхности вырастали кристаллиты Si, имеющие собственную огранку (рис. 1). Затем производилась T - F обработка этого конденсата при различных $T_{об}$ и $F_{об}$, т.е. напряжений обработки $U_{об}$. Напряжение $U_{об}$ имеет знак, обратный тому, при котором катод дает эмиссионный электронный ток. После каждого цикла обработки при определенных $T_{об}$ и $F_{об}(U_{об})$ снимались эмиссионные характеристики Фаулера-Нордгейма и определялись параметры эмиттера: фактор поля $\alpha = F/U$ и напряжение U_{10} , необходимое для получения фиксированного значения эмиссионного тока 10 нА. Во всех экспериментах использовалась стандартная продолжительность T - F обработки для каждого цикла — одна минута.

При наиболее низких $T_{об} = 700$ К и $U_{об} = 8-10$ кВ ($F_{об} = 0.44-0.55$ В/А) происходило очень слабое “заострение” эмиттера, поскольку U_{10} падало от исходного значения 7190 до 6280 В, т.е. на ~13%. При этом полевое электронное изображение поверхности (рис. 1, б) практически не обнаруживало заметных изменений по сравнению с исходным состоянием (рис. 1, а). Рост $T_{об}$ до 780 К и $F_{об}$ до 0.66 В/А приводит к заметной перестройке поверхности конденсата в электрическом поле, в этом случае эмиттируют только ребра расширившихся граней (рис. 1, в). Перестройка поверхности приводит уже к значительному падению $U_{10} = 4700$ В и росту α от исходной величины 5463 до 94711/см. Повышение $T_{об}$ до 870 К при том же $F_{об} = 0.66$ В/А вызывает появление на поверхности микровыступов (рис. 1, г), однако эти микровыступы не “острые” и высота их незначительна, в этом случае $U_{10} = 4540$ В, т.е. меньше исходного в 1.58 раза, а $\alpha = 102871$ /см, что больше исходного в 1.88 раза. Дальнейший рост $U_{об}$ до 15 кВ (при этом $F_{об} = 0.82$ В/А) вызывает некоторое затупление микровыступов и U_{10} уже несколько возрастает до 5040 В. Осторожное сглаживание микровыступов прогревом острия при $T = 870$ К в отсутствие внешнего поля демонстрирует наличие на поверхности больших наростов — макронаростов, выросших на кристалликах Si, на углах и ребрах макронаростов, и растут микровыступы (рис. 1, д). Это означает, что на кристаллически упорядоченных адсорбированных слоях наблюдаются те же типы формоизменений поверхности при T - F воздействии, что и для чистых металлов — перестройка в электрическом поле, образование микровыступов и макронаростов [3]. Таким образом, при $T_{об}$, вплоть до 870 К и $U_{об}$, примерно в 1.5–1.6 раза превышающих исходное U_{10} , можно “заострить” эмиттер по напряжению в 1.5–1.6 раза.

Радикальные изменения происходят с эмиттером при $T_{об} = 980$ К. Уже при $U_{об} = 9$ кВ величина $U_{10} = 4110$ В падает по сравнению с исходной в 1.75 раза, а α растет

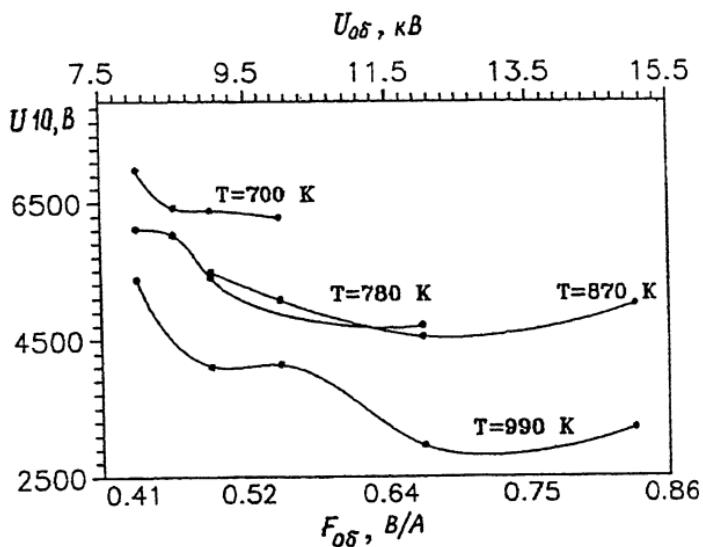


Рис. 2. Зависимость величины U_{10} от $F_{0\delta}$ при различных $T_{0\delta}$.

до 119031/см. Эмиссионная картина показывает наличие нескольких яркоэмиттирующих микровыступов и углов перестроенного острия. Увеличение $U_{0\delta}$ до 12 кВ и $F_{0\delta}$ до 0.66 В/А вызывает образование на поверхности 2–3 весьма острых микровыступов (рис. 1, e), при этом U_{10} падает до 2960 В, т.е. в 2.43 раза, и α возрастает до 183751/см. Дальнейшее повышение $U_{0\delta}$ до 15 кВ ($F_{0\delta} = 0.82$ В/А) так же, как и в случае $T_{0\delta} = 870$ К, приводит к слабому затуплению эмиттера и изменению числа микровыступов (рис. 1, ж). Очевидно, что при прогреве уже до $T = 870$ К и особенно при

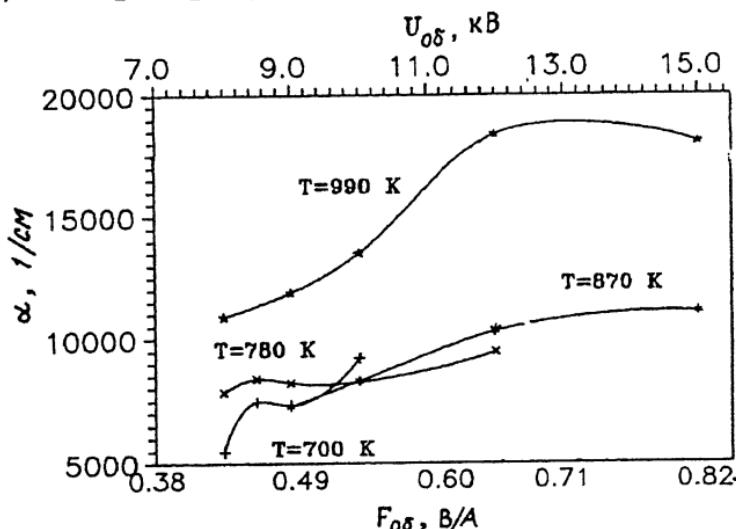


Рис. 3. Зависимость величины фактора поля α от $F_{0\delta}$ при разных $T_{0\delta}$.

$T = 980$ К происходит объемная диффузия Si с образованием силицида WSi_2 [4]. Изменение величин U_{10} и α в зависимости от U_{ob} и T_{ob} показано на рис. 2 и 3 соответственно.

Таким образом, T - F обработка эмиттеров из конденсата Si на W при невысоких $T < 1000$ К и умеренных $F = 0.3$ – 0.8 В/А (при этом U_{ob} в 1.5–1.6 раза больше величины, при которой исходный эмиттер дает весьма слабый ток 10 нА), может приводить к таким формоизменениям эмиттера, когда напряжение, необходимое для получения фиксированного значения эмиссионного тока, может падать в 2.0–2.5 раза, т.е. T - F обработка при правильно подобранных величинах T_{ob} и U_{ob} обеспечивает значительное повышение эффективности катода.

Список литературы

- [1] Spindt C.A., Brodie I., Humphrey L., Westerberg E.R. // Journ. Appl. Phys. 1976. V. 42. P. 5248–5253.
- [2] Gray H.F. Proceeding of the 29th Field Emission Symposium. Goteborg, 1982. P. 111–119.
- [3] Шредник В.Н. Рост кристаллов. М.: Наука, 1980. С. 326.
- [4] Nishikawa O., Matsushima T., Aruma K. // Surf. Sci. 1983. V. 126. N. 4. P. 529–532.

Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе
С.-Петербург

Поступило в Редакцию
5 сентября 1995 г.